

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**PRIORITY
DOCUMENT**SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

EP04/51634

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

REC'D 30 AUG 2004

WIPO PCT

Aktenzeichen:

103 35 338.0

Anmeldetag:

1. August 2003

Anmelder/Inhaber:

Siemens Aktiengesellschaft, 80333 München/DE

Bezeichnung:Elektronikeinheit sowie Verfahren zur Herstellung
einer Elektronikeinheit**IPC:**

H 05 K, B 60 R

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**München, den 17. Juni 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag**Dzierzon**

BEST AVAILABLE COPY

Beschreibung

Elektronikeinheit sowie Verfahren zur Herstellung einer Elektronikeinheit

5

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Elektronikeinheit, insbesondere ein Steuergerät für ein Kraftfahrzeug, umfassend wenigstens eine mit elektronischen Komponenten bestückte Leiterplatte und ein die Leiterplatte umschließendes Gehäuse.

10

Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung sowie eine Verwendung einer derartigen Elektronikeinheit.

15

Aus dem Bereich der Kraftfahrzeugelektronik sind Steuergeräte zur Steuerung von elektrischen und elektronischen Fahrzeugkomponenten (z. B. Motorsteuergeräte) wohlbekannt, bei welchen zu Zwecken einer erhöhten Temperaturbeständigkeit die Schaltungsplatte (Schaltungsträger) mittels Dickschichttechnik oder Laminattechnik hergestellt ist.

20

Bei der Dickschichttechnik wird beispielsweise ein relativ dickes Keramiksubstrat mit ebenfalls relativ dicken aufgetragenen Leiterbahnen vorgesehen. Dies hat deutliche Kosten-
nachteile, da die Fertigung einer solchen Leiterplatte wesentlich teurer ist als die Fertigung einer einfachen Leiterplatte (z. B. mit einem dünnen Epoxid-Substrat).

25

30

Bei der Laminattechnik wird beispielsweise eine herkömmliche Leiterplatte durch Anwendung eines hohen Drucks und einer hohen Temperatur mit einer Metalllage zu einem Verbund zusammengefügt. Nachteilig ist hierbei, dass die in Laminattechnik hergestellte Leiterplatte lediglich einseitig mit elektronischen Komponenten bestückt werden kann, so dass bei vorgegebener elektronischer Schaltungsanordnung der Flächenbedarf im

Vergleich zu herkömmlichen, jedoch zweiseitig bestückten Leiterplatten erhöht ist. Eine Vermeidung des erhöhten Flächenbedarfs beispielsweise durch Anordnung von zwei oder mehreren Leiterplatten übereinander ist oftmals nicht zufriedenstellend, da in diesem Fall der Bauraum sowie der Montageaufwand erhöht ist.

Ganz allgemein ist es in vielen Anwendungsfällen von Bedeutung, eine effiziente Wärmeabfuhr von den elektronischen Komponenten zum Gehäuse zu realisieren, insbesondere wenn in der Elektronikereinheit z. B. aktive Halbleiterleistungsbaulemente zum Einsatz kommen und/oder die Elektronikereinheit in einer Umgebung mit vergleichsweise hoher Umgebungstemperatur eingesetzt werden soll. Dies ist beispielsweise bei Steuergeräten für Kraftfahrzeuge der Fall, die in einem Kraftfahrzeug nahe oder unmittelbar an einer Brennkraftmaschine angeordnet werden, um z. B. die Kabelbaumkonfiguration des Fahrzeugs zu vereinfachen oder um eine elektronische Prüfung des Motors zusammen mit dem dazugehörigen Steuergerät in einfacher Weise zu ermöglichen. Für die bekannten motornah verbauten Steuergeräte wird üblicherweise die oben erwähnte Dickschichttechnik oder Laminattechnik verwendet.

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Elektronikereinheit der eingangs erwähnten Art hinsichtlich der Wärmeabfuhereigenschaften sowie hinsichtlich der Herstellungskosten zu verbessern.

Diese Aufgabe wird gelöst mit einer Elektronikereinheit nach Anspruch 1 und einem Verfahren zur Herstellung einer Elektronikereinheit nach Anspruch 11. Die abhängigen Ansprüche betreffen vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung.

Die erfindungsgemäße Elektronikeinheit besitzt wenigstens einen Leiterplattenabschnitt, der in einem Abstand von dem Gehäuse angeordnet ist und zweiseitig mit elektronischen Komponenten bestückt ist. Dieser oder diese Leiterplattenabschnitte werden im Folgenden als "erste(r) Leiterplattenab-

schnitt(e)" bezeichnet. Ferner besitzt die Leiterplatte wenigstens einen Leiterplattenabschnitt, der über eine wärmeleitende Klebstoffschicht mit dem Gehäuse verbunden ist. Dieser oder diese Leiterplattenabschnitte werden im Folgenden

als "zweite(r) Leiterplattenabschnitt(e)" bezeichnet. Bei einem mehrteiligen Gehäuse kann diese Verklebung an dem oder den zweiten Leiterplattenabschnitten zu irgendeinem der Gehäuseteile erfolgen. Durch die partiell doppelseitige Bestückung (in dem wenigstens einen ersten Leiterplattenabschnitt)

ergibt sich ein vergleichsweise geringer Flächenbedarf, insbesondere wenn der Anteil des oder der ersten Leiterplattenabschnitte an der Gesamtleiterplattenfläche wenigstens 30% beträgt. Darüber hinaus wirkt der zweite Leiterplattenab-

schnitt vorteilhaft als mechanische und gleichzeitig thermische "Schnittstelle" zum Gehäuse, welches in dieser Hinsicht als mechanische Basis sowie Wärmesenke zu betrachten ist.

Diese Schnittstelle von doppeltem Nutzen ist hierbei durch die Verbindung über eine Klebstoffschicht sehr zuverlässig, effizient, fertigungstechnisch günstig und bauraumsparend ausgebildet.

Nachfolgend wird der Einfachheit halber auch lediglich von dem ersten Leiterplattenabschnitt bzw. zweiten Leiterplattenabschnitt gesprochen, wenngleich jeweils mehrere solcher Abschnitte vorgesehen sein können. Die für einen solchen Leiterplattenabschnitt gegebenen Erläuterungen können dann ohne weiteres auf einen, mehrere oder alle der jeweiligen Mehrzahl von Leiterplattenabschnitten bezogen werden.

Die mit der Klebstoffschicht versehene Seite des zweiten Leiterplattenabschnitts ist bevorzugt mit einer Metallfläche (ausgedehnte Leiterbahn) versehen, um an dieser Stelle eine

5 horizontale Wärmespreizung und gleichzeitig eine gute thermische Anbindung an die angrenzende Klebstoffschicht zu erzielen. Die der Klebstoffschicht entgegengesetzte Seite eines zweiten Leiterplattenabschnitts eignet sich gut für eine Bestückung mit elektronischen Komponenten, die besonders viel
10 Wärme produzieren, da diese Wärme über die nahe darunter be-

findliche Klebstoffschicht mit geringem Wärmeübergangswiderstand weitergeleitet werden kann, insbesondere über an dieser Stelle angeordnete wärmeleitend metallisierte Durchgangsöffnungen ("vias").

15

Bevorzugt wird der Klebstoff als Flüssigklebstoff aufgebracht und dann ausgehärtet. Die Aushärtung des Klebstoffs kann in einfacher Weise thermisch vorgesehen sein. Für eine gute Wärmeableitungseffizienz ist die Verwendung eines Klebstoffs mit
20 einer Wärmeleitfähigkeit von mindestens 0,5 W/mK, insbesondere mindestens 1 W/mK bevorzugt.

Die Klebstoffschichtverbindung zwischen der Leiterplatte und dem Gehäuse macht die bei herkömmlichen Elektronikeinheiten
25 zur Befestigung üblicherweise vorgesehene Verschraubung entbehrlich. Falls die Elektronikeinheit mit einer Mehrzahl von parallel zueinander gestapelten Leiterplatten vorgesehen ist, so können die weiteren Leiterplatten beispielsweise unter Verwendung von geeigneten Abstandhaltern ebenfalls durch eine
30 Verklebung und/oder eine herkömmliche Verschraubung im Inneren des Gehäuses befestigt werden.

In einer Ausführungsform umfasst das Gehäuse einen Gehäuseboden und einen damit verbundenen Gehäusedeckel. Dies besitzt den Vorteil, dass die Fertigung der Elektronikeinheit in einfacher Weise dadurch erfolgen kann, dass die bereits bestückte Leiterplatte zunächst in eines dieser Gehäuseteile eingeklebt wird und das Gehäuse dann durch Verbindung zwischen Gehäuseboden und Gehäusedeckel geschlossen wird. Für eine gute Wärmeableitung durch das Gehäuse hindurch ist es von Vorteil, wenn das Gehäuse insgesamt oder wenigstens der über die Klebstoffschicht mit der Leiterplatte thermisch verbundene Gehäuseteil aus einem gut wärmeleitenden Material gebildet ist, beispielsweise aus Metall (z. B. Aluminiumlegierung).

In einer bevorzugten Ausführungsform weist der Gehäuseboden im Querschnitt betrachtet Einbuchtungen zur Bereitstellung von Gehäuseinnenseitenabschnitten auf, die zur Verbindung mit dem wenigstens einen zweiten Leiterplattenabschnitt über die Klebstoffschicht verwendet sind.

Eine hinsichtlich der Fertigung einfache Verbindung zwischen Gehäuseboden und Gehäusedeckel kann beispielsweise durch eine geklebte Nut-und-Vorsprung-Verbindung realisiert sein. Hierfür kann insbesondere der ohnehin für die Verbindung zwischen Leiterplatte und Gehäuse benötigte Klebstoff verwendet werden. Einen guten Schutz des Gehäuseinnenraums vor einer Verschmutzung bietet eine Gestaltung, bei welcher ein an einem Gehäuseteil (Boden oder Deckel) ringförmig geschlossen am Rand umlaufender Vorsprung in eine am anderen Gehäuseteil korrespondierend angeordnete Nut eingreift.

Insbesondere für eine niedrige Bauhöhe der Elektronikeinheit ist es zur Bereitstellung einer elektrischen Anschlussmöglichkeit günstig, in dem Gehäusedeckel wenigstens einen

Steckverbinder zum elektrischen zu integrieren. Hierbei können Anschlusspins des Steckverbinders geradlinig zu der dem Gehäusedeckel benachbarten Leiterplatte verlaufen und unmittelbar an dieser Leiterplatte kontaktiert sein. Insbesondere bei diesem geradlinigen Anschlusspinverlauf kann die Kontaktierung in einfacher Weise als Einpresskontaktierung vorgesehen sein und beispielsweise beim Schließen des Gehäuses durch Aufsetzen des mit dem oder den Steckverbindern versehenen Gehäusedeckels auf den Gehäuseboden.

Die konkrete Anordnung des oder der zweiten Leiterplattenabschnitte (in der Leiterplattebene betrachtet) spielt eine Rolle hinsichtlich der Befestigung sowie der thermischen Ableitungseigenschaften. In diesem Zusammenhang hat es sich als günstig herausgestellt, wenn wenigstens zwei zweite Leiterplattenabschnitte vorgesehen sind, deren minimaler gegenseitiger Abstand größer als 40% einer maximalen Leiterplattenausdehnung ist. Dies wirkt vor allem vorteilhaft für eine stabile Lagerung der an den zweiten Leiterplattenabschnitten gehaltenen Leiterplatte. Unabhängig davon ist es günstig, wenn an einem Leiterplattenrand wenigstens einer der zweiten Leiterplattenabschnitte angeordnet ist. Schließlich ist es in dieser Hinsicht auch günstig, wenn wenigstens einer der zweiten Leiterplattenabschnitte entlang eines Großteils eines Leiterplattenrands verläuft, insbesondere ringförmig geschlossen entlang eines Leiterplattenrands verläuft. Eine solche ringförmige Anbindung der Leiterplatte an das Gehäuse hält die Leiterplatte besonders stabil und führt im Betrieb der Elektronikeinheit zu einer besonders gleichmäßigen Wärmeabfuhr.

Sofern die der Klebstoffschicht entgegengesetzte Leiterplatenseite an einem ersten Leiterplattenabschnitt nicht mit e-

lektronischen Komponenten bestückt ist, so ist diese Stelle günstig zur Anordnung einer Leiterbahnfläche, die als Wärmespreizungsfläche wirkt und die aufgenommene Wärme effizient an die darunter befindliche Klebstoffschicht abgeben kann.

5

Ein einfaches Verfahren zur Herstellung der Elektronikeinheit kann beispielsweise folgende Schritte umfassen:

- Bereitstellen der bereits bestückten Leiterplatte,
 - Bereitstellen eines konturierten Gehäusebodens mit erhabenen Gehäuseinnenseitenbereichen und mit einer am Rand des Gehäusebodens umlaufenden Nut,
 - Aufbringen von Flüssigklebstoff an den erhabenen Gehäusebodenflächen und an dem Nutengrund,
 - Aufdrücken der Leiterplatte zur Verklebung dieser Leiterplatte an den erhabenen Gehäusebodenflächen,
 - Bereitstellen eines Gehäusedeckels mit einem zum Eingriff in die Gehäusebodennut geeigneten Vorsprung, und
 - Aufdrücken des Gehäusedeckels auf den Gehäuseboden zur Herstellung einer geklebten Nut-und-Vorsprung-Verbindung zwischen Gehäuseboden und Gehäusedeckel sowie zur Kontaktierung von Anschlusspins der Steckverbinderanordnung in Einpresstechnik.
- Eine Steckverbindungsanordnung kann z. B. nach dem Bestücken der Leiterplatte mittels Einpresstechnik an der Leiterplatte kontaktiert werden, bevor die Leiterplatte verklebt wird. Alternativ ist es z. B. möglich, die Steckverbindungsanordnung

10

15

20

25

30

am Gehäusedeckel integriert vorzusehen und zusammen mit dem Gehäusedeckel aufzudrücken.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es stellen dar:

Fig. 1 eine Explosionsansicht eines Steuergeräts für ein Kraftfahrzeug,

10

Fig. 2 eine Schnittansicht des Steuergeräts im montierten Zustand mit einer in einer Längsrichtung verlaufenden Schnittebene, und

15 Fig. 3 eine Schnittansicht des Steuergeräts im montierten Zustand mit einer in einer Querrichtung verlaufenden Schnittebene.

Die Figuren 1 bis 3 zeigen ein insgesamt mit 10 bezeichnetes Steuergerät für ein Kraftfahrzeug. Das Steuergerät 10 ist gebildet aus einer starren, mit elektronischen Komponenten bestückten Leiterplatte 12 (z. B. Epoxid-Substrat mit Kupferleiterbahnen bzw. -flächen) und einem diese Leiterplatte umschließenden Gehäuse, welches zweiteilig umfassend einen Gehäuseboden 14 (Grundplatte) und einen Gehäusedeckel 16 ausgebildet ist. Zum elektrischen Anschluss des Steuergeräts an die Fahrzeugelektronik des betreffenden Kraftfahrzeugs (bzw. an ein Prüfgerät) sind zwei Steckverbinder 18, 20 vorgesehen, die im dargestellten Ausführungsbeispiel zur Kontaktierung mittels Einpresstechnik bei der Steuergerätmontage auf die Oberseite der Leiterplatte 12 aufgesetzt und mit dem Gehäuseboden 14 verschraubt werden. Zu diesem Zweck sind die Steckverbindergehäuse mit Befestigungsschrauben 22 versehen, wel-

che im montierten Zustand Aussparungen 24 der Leiterplatte 12 durchsetzen und in entsprechende Befestigungslöcher 26 des Gehäusebodens 14 eingeschraubt sind. Nach außen hin durchsetzen die Steckverbinder 18, 20 geeignet bemessene Durchtrittsaussparungen 28 des Gehäusedeckels 16.

Der wie der Gehäusedeckel 16 aus einer Aluminiumlegierung gebildete Gehäuseboden 14 besitzt eine konturierte Formgebung derart, dass sich in einem mittleren Bereich des Bodens 14 ein zusammenhängender, etwa rechteckiger, vertiefter Gehäuseinnenseitenabschnitt 30 ergibt, der an dessen Rand umlaufend an einen erhabenen Gehäuseinnenseitenabschnitt 32 angrenzt.

Dieser Anordnung von vertieften und erhabenen Gehäuseabschnitten 30, 32 entsprechend weist die Leiterplatte 12 einen zusammenhängenden mittleren Leiterplattenabschnitt 34 (erster Leiterplattenabschnitt) auf, der im montierten Zustand in einem gewissen Abstand von dem Gehäuseboden angeordnet ist und der zweiseitig mit elektronischen Komponenten bestückt ist, wohingegen die Leiterplatte 12 einen ringförmig geschlossen am Leiterplattenrand verlaufenden äußeren Leiterplattenabschnitt 36 (zweiter Leiterplattenabschnitt) aufweist, dessen Unterseite über eine wärmeleitende Klebstoffschicht 42 (Fig. 2 und 3) unmittelbar mit dem erhabenen Gehäuseinnenseitenabschnitt 32 verbunden ist.

Diese partielle Anbindung der Leiterplatte 12 über die Klebstoffschicht 42 gewährleistet eine zuverlässige mechanische Halterung der Leiterplatte 12 und wirkt darüber hinaus als effizienter Ableitungspfad für Wärme, die im Betrieb des Steuergeräts 10 von den elektronischen Komponenten erzeugt wird. Der Klebstoff besitzt eine Wärmeleitfähigkeit von etwa

2 W/mK. Daher eignet sich das Steuergerät 10 insbesondere für einen motornahen Verbau in einem Kraftfahrzeug, da der beschriebene Aufbau die hinsichtlich mechanischen Belastungen (z. B. Vibrationen) und Temperatur rauen Umgebungsbedingungen gut bewältigen kann.

Bei dem dargestellten Motorsteuergerät 10 kommen eine Anzahl von aktiven Leistungshalbleiterbauelementen zum Einsatz, beispielsweise in einem Schaltungsbereich zur DC/DC-Abwärtswandlung einer Bordspannung für die Versorgung eines Schaltungsteils zur digitalen Signalverarbeitung sowie in einem Schaltungsbereich zur DC/DC-Aufwärtswandlung für die Versorgung eines Schaltungsteils zur Ansteuerung einer Kraftstoffinjektoranordnung der Brennkraftmaschine. Diese elektronischen Leistungsbauteile sind weitgehend auf der Oberseite des äußeren Leiterplattenabschnitts 36 angeordnet, da von diesem Abschnitt weg eine effiziente Wärmeableitung nach unten durch die Klebstoffschicht 42 hindurch zum Gehäuse erfolgen kann.

Die bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel verwendeten Steckverbinder 18, 20 besitzen geradlinig nach unten verlaufende Anschlusspins, die sich fertigungstechnisch einfach in entsprechend dimensionierte Kontaktlöcher der Leiterplatte 12 einpressen lassen ("Press-fit-Technik). Ein weiterer Vorteil der Verwendung von solchen ungebogenen Anschlusspins besteht darin, dass sich die Steckverbinder 18, 20 hinsichtlich der Grundfläche des Steuergeräts 10 günstig im Gehäusedeckel 16 integrieren lassen (sei es vor oder nach dem Schließen des Gehäuses) und nicht wie oftmals bei herkömmlichen Steuergeräten in einem Gehäuseseitenwandbereich integriert sind und somit die Grundfläche des Gehäuses unnötig vergrößern. Die Kontaktierung der Anschlusspins im mittleren Leiterplattenab-

schnitt 34 hat schließlich den Vorteil, dass die von elektronischen Komponenten zu den Anschlusspins führenden Leiterbahnen der Leiterplatte 12 vergleichsweise einfach im Sinne eines weniger komplizierten Schaltungsplattenlayouts angeordnet

5 werden können. Insbesondere können die Leiterbahnen tendenziell kürzer und direkter zwischen einzelnen Komponenten und einzelnen Anschlusspins verlaufen. Im Gegensatz dazu ist bei einer Kontaktierung im Randbereich der Leiterplatte, wie sie oftmals bei herkömmlichen Steuergeräten mit abgewinkelten

10 Steckverbinder-Anschlusspins vorgesehen ist, das Leiterplattenlayout aufwändiger bzw. weniger kompakt hinsichtlich der beanspruchten Leiterplattenfläche. Hinsichtlich der Wärmeableitungseigenschaften des beschriebenen Steuergeräts 10 ist die zentrumsnahe Anordnung der Steckverbinder 18, 20 darüber
15 hinaus auch insofern vorteilhaft, als die eher wärmeableitenden als wärmeerzeugenden Anschlusspins in demjenigen Leiterplattenabschnitt (34) angeordnet sind, der weniger effizient gekühlt wird als der äußere Leiterplattenabschnitt 36, und insofern, als die Anschlusspins keine Leiterplattenfläche im
20 effizient gekühlten äußeren Leiterplattenabschnitt 36 beanspruchen, der zur Bestückung mit stark wärmeerzeugenden Komponenten (z. B. Leistungstransistoren) bevorzugt zu verwenden ist.

25 Zur Montage des Steuergeräts 10 wird der erhabene Gehäuseinnenseitenabschnitt 32 sowie der Grund einer am Gehäuseboden 14 umlaufenden Nut 38 mit einem Flüssigklebstoff (z. B. auf Silikonbasis) versehen. Sodann wird die bereits bestückte Leiterplatte 12 im Gehäuseboden 14 positioniert und auf die
30 Klebstoffschicht aufgelegt. Anschließend werden die Steckverbinder 18, 20 mit deren Anschlusspins in Einpresstechnik an der Leiterplatte 12 kontaktiert und mittels der Befestigungsschrauben 22 befestigt. Beim dargestellten Ausführungs-

beispiel wirkt die Verschraubung der Steckverbinder 18, 20 als zusätzliche (an sich nicht notwendige) Befestigung der Leiterplatte 12 im Gehäuseboden 14. Schließlich wird der Gehäusedeckel 16 von oben derart aufgesetzt, dass ein an dessen Rand umlaufend sich erstreckender Vorsprung 40 mit der Nut 38 in Eingriff gelangt und verklebt wird. Alternativ können die Steckverbinder 18, 20 zunächst auf der Leiterplattenoberseite angebracht werden. Wenn an den Steckverbindern umlaufend eine Nut vorgesehen ist, so kann auch die Verbindung zwischen den Steckverbindern 18,20 und dem Gehäusedeckel 16 vorteilhaft mittels einer Nut-und-Vorsprung-Verklebung realisiert werden.

Patentansprüche

1. Elektronikeinheit, insbesondere Steuergerät für ein Kraftfahrzeug, umfassend eine mit elektronischen Komponenten bestückte Leiterplatte (12) und ein die Leiterplatte umschließendes Gehäuse (14, 16),

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Leiterplatte (12) wenigstens einen ersten Leiterplattenabschnitt (34) besitzt, der in einem Abstand von dem Gehäuse (14, 16) angeordnet ist und zweiseitig mit elektronischen Komponenten bestückt ist, und wenigstens einen zweiten Leiterplattenabschnitt (36) besitzt, der über eine wärmeleitende Klebstoffschicht (42) mit dem Gehäuse verbunden ist.

2. Elektronikeinheit nach Anspruch 1, wobei das Gehäuse (14, 16) einen Gehäuseboden (14) und einen damit verbundenen Gehäusedeckel (16) umfasst und wobei der Gehäuseboden oder der Gehäusedeckel (16) im Querschnitt betrachtet Einbuchtungen zur Bereitstellung von Gehäuseinnenseitenabschnitten (32) aufweist, die zur Verbindung mit dem wenigstens einen zweiten Leiterplattenabschnitt (36) über die Klebstoffschicht (42) verwendet sind.

3. Elektronikeinheit nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Gehäuse einen Gehäuseboden (14) und einen mittels einer geklebten Nut-und-Vorsprung-Verbindung (38, 40) damit verbundenen Gehäusedeckel (16) umfasst.

4. Elektronikeinheit nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei das Gehäuse (14, 16) einen Gehäuseboden (14) und einen damit verbundenen Gehäusedeckel (16) umfasst und wobei in dem

Gehäusedeckel wenigstens ein Steckverbinder (18, 20) zum elektrischen Anschluss der Elektronikeinheit integriert ist.

- 5 5. Elektronikeinheit nach Anspruch 4, wobei Anschlusspins des Steckverbinders (18, 20) geradlinig zu der Leiterplatte (12) verlaufen und unmittelbar an dieser Leiterplatte kontaktiert sind.
- 10 6. Elektronikeinheit nach Anspruch 5, wobei die Kontaktierung der Anschlusspins als Einpresskontaktierung vorgesehen ist.
- 15 7. Elektronikeinheit nach einem der vorangehenden Ansprüche, mit wenigstens zwei zweiten Leiterplattenabschnitten (36), deren minimaler gegenseitiger Abstand größer als 40% einer maximalen Leiterplattenausdehnung ist.
- 20 8. Elektronikeinheit nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei an einem Leiterplattenrand wenigstens einer der zweiten Leiterplattenabschnitte (36) angeordnet ist.
- 25 9. Elektronikeinheit nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei wenigstens einer der zweiten Leiterplattenabschnitte (36) entlang eines Großteils eines Leiterplattenrands verläuft, insbesondere ringförmig geschlossen entlang eines Leiterplattenrands verläuft.
- 30 10. Elektronikeinheit nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei wenigstens einer der ersten Leiterplattenabschnitte (34) auf der der Klebstoffschicht (42) entgegengesetzten Leiterplattenseite mit elektronischen Komponenten bestückt ist.

11. Verfahren zur Herstellung einer Elektronikeinheit (10)
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1,

5 g e k e n n z e i c h n e t durch folgende Schritte:

10 - Bereitstellen der Leiterplatte (12) mit wenigstens einem ersten Leiterplattenabschnitt (34), der zweiseitig mit elektronischen Komponenten bestückt ist, und mit wenigstens einem zweiten Leiterplattenabschnitt (36), der auf einer Seite nicht mit elektronischen Komponenten bestückt ist,

15 - Bereitstellen des Gehäuses (14, 16) in einem geöffneten Zustand,

20 - Verbinden der zweiten Leiterplattenabschnitte (36) an deren nicht bestückter Seite über eine wärmeleitende Klebstoffschicht (42) mit einer Gehäuseinnenseite (14), und

- Schließen des Gehäuses (14, 16).

Zusammenfassung

Elektronikeinheit sowie Verfahren zur Herstellung einer Elektronikeinheit

5

Elektronikeinheit, insbesondere Steuergerät für ein Kraftfahrzeug, umfassend eine mit elektronischen Komponenten bestückte Leiterplatte (12) und ein die Leiterplatte umschließendes Gehäuse (14, 16),

10

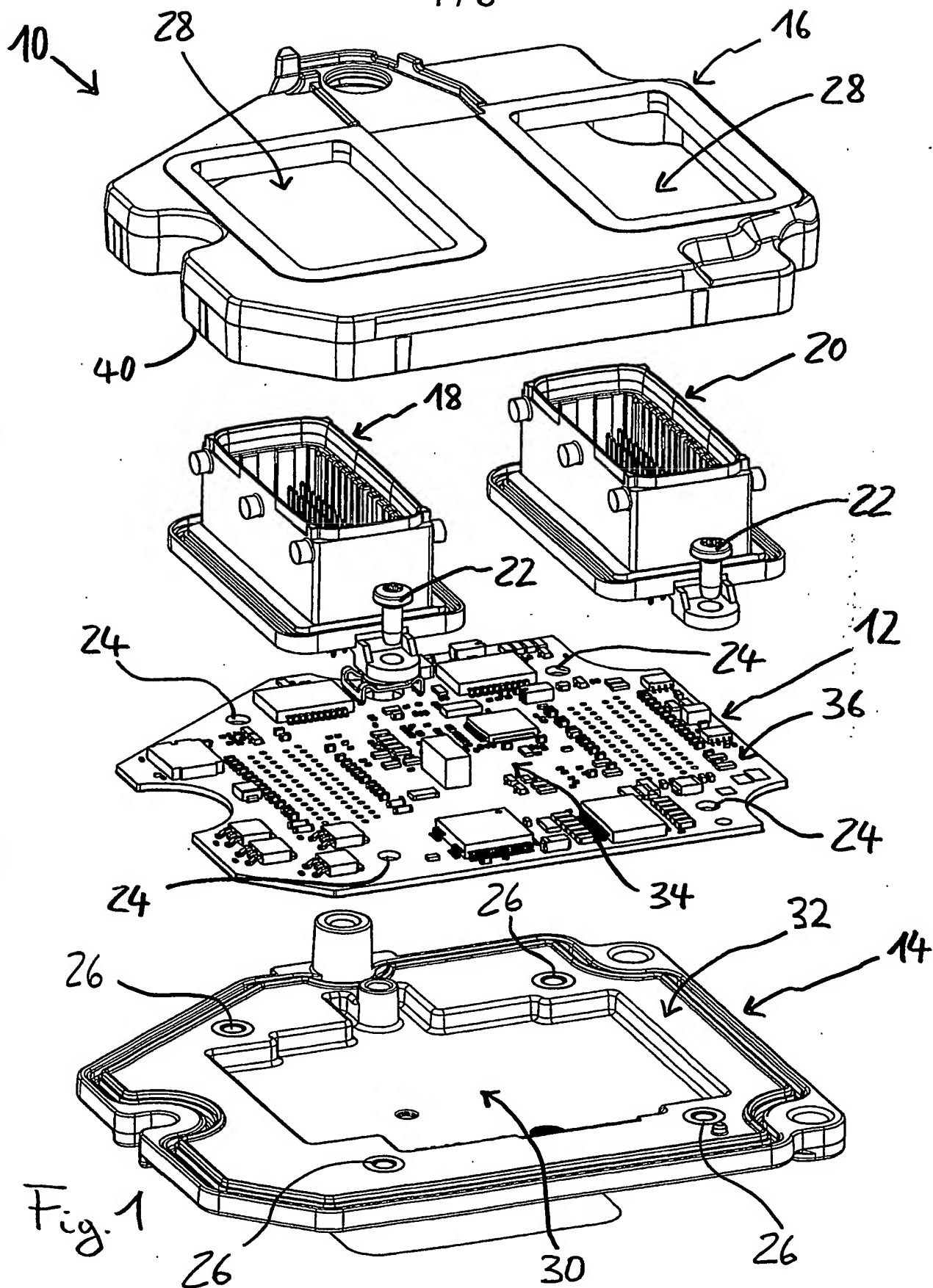
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Leiterplatte (12) wenigstens einen ersten Leiterplattenabschnitt (34) besitzt, der in einem Abstand von dem Gehäuse (14, 16) angeordnet ist und zweiseitig mit elektronischen Komponenten bestückt ist, und wenigstens einen zweiten Leiterplattenabschnitt (36) besitzt, der über eine wärmeleitende Klebstoffschicht (42) mit dem Gehäuse verbunden ist.

15

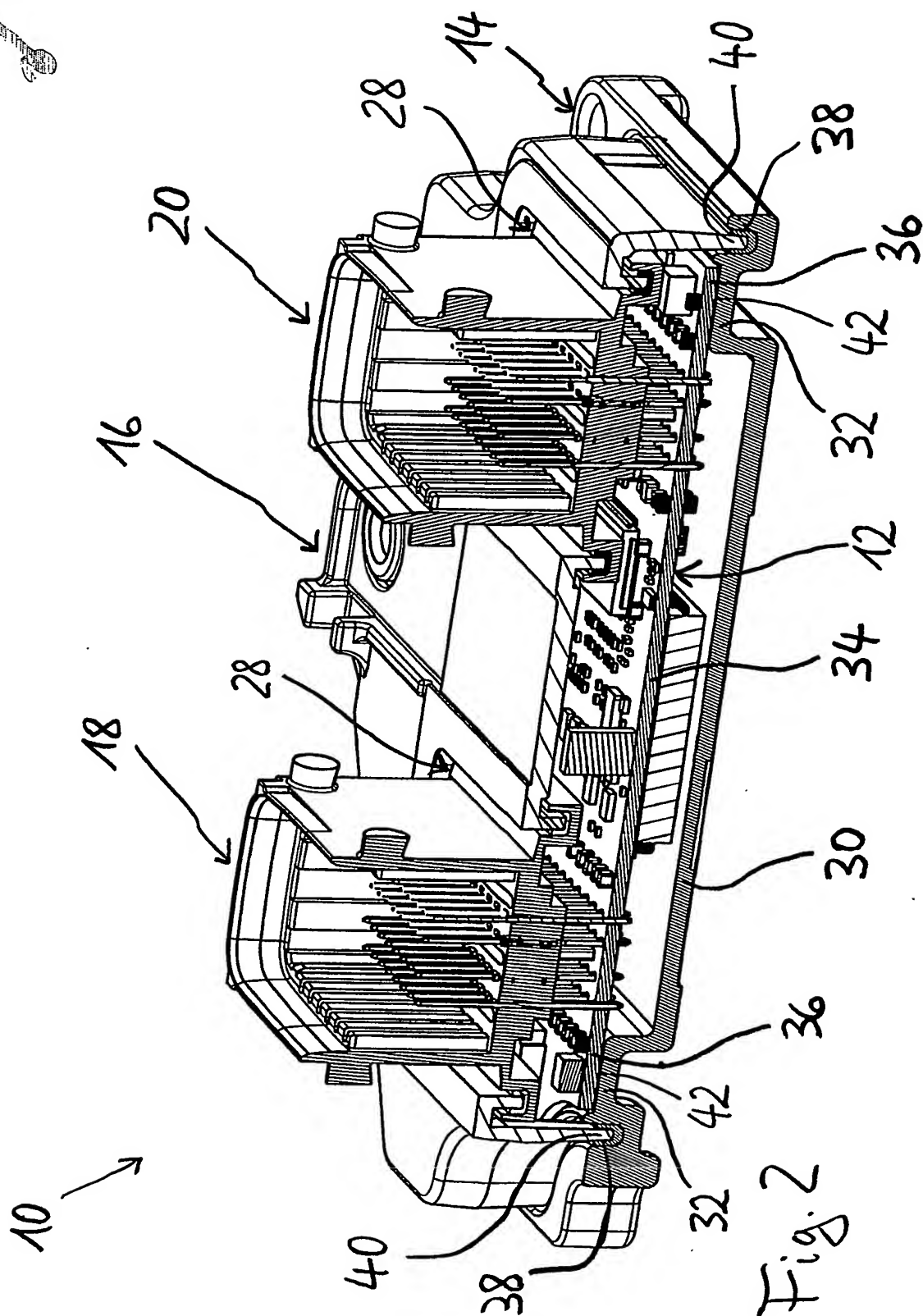
(Figur 2)

20

1 / 3



2 / 3



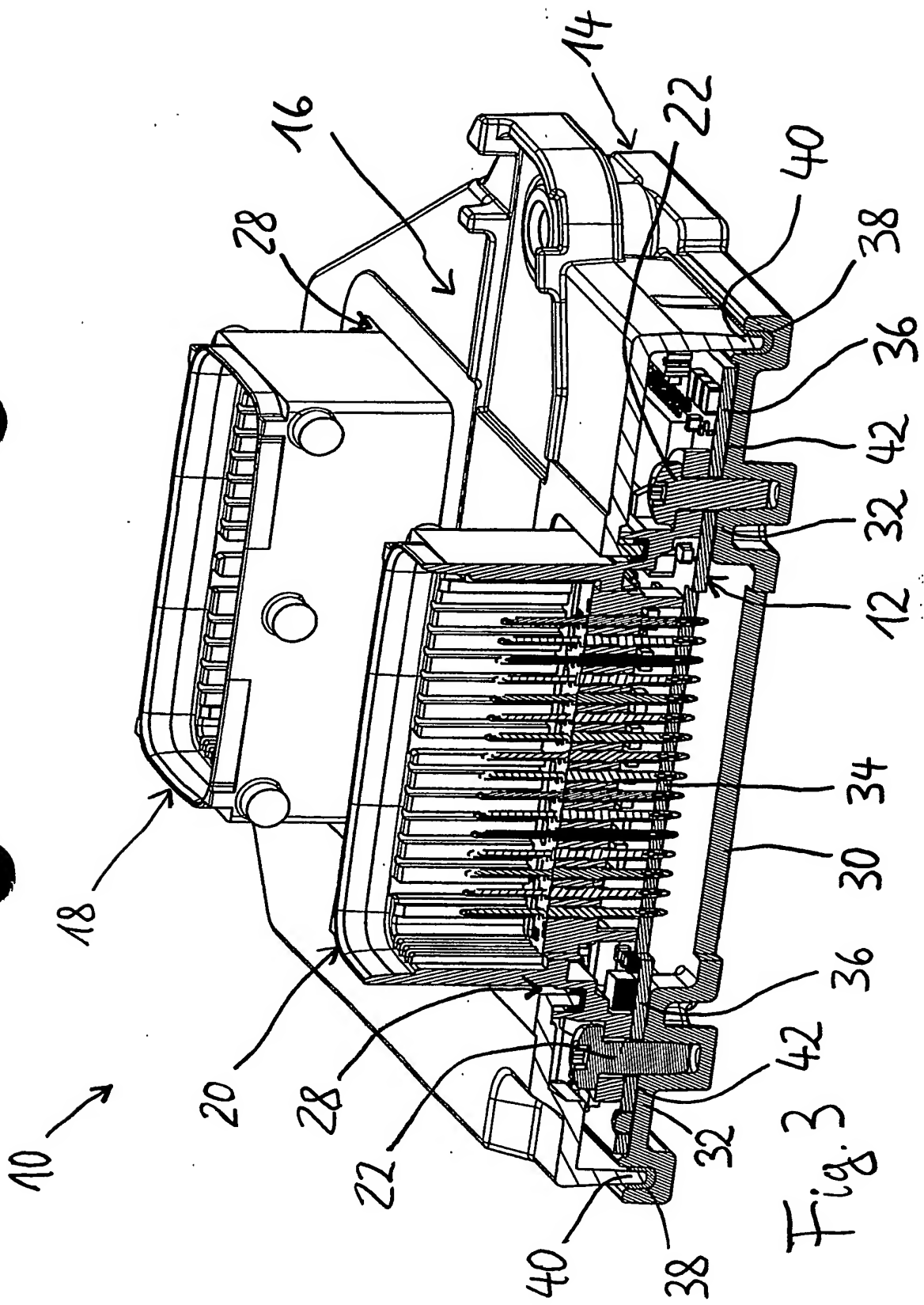


Fig. 3

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.